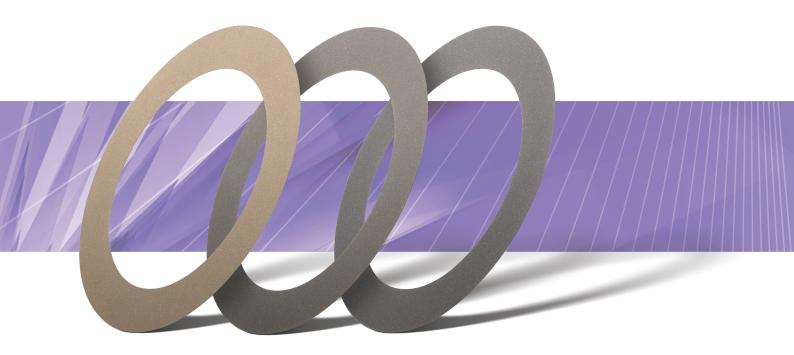
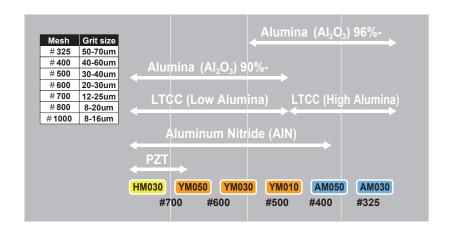
PRECISION ACCRETECH BLADE

METAL BOND BLADES セラミック用 メタルブレード YM/AMシリーズ





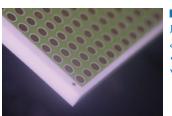
高窒化アルミ(AIN)、窒化ケイ素(Si₃N₄)や 高純度アルミナ(Al₂O₃)を高品質で 切断可能なメタルYM/AMシリーズ





■加工例 AMシリーズ

■ アルミナ基板LEDの切断 従来のメタルブレードでは切味が 低下し個片化時にプロトリューショ ンが発生しておりましたが、A Mシリ ーズでは切味がよく垂直に切断可 能となりました。



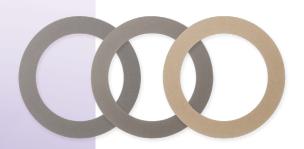
加工例 YMシリーズ

■ LTCCの切断

厚いLTCCに対しても切れ味の改善によりチッピング、欠けが発生することなく切断が可能となりました。 YM030使用。

PRECISION ACCRETECH BLADE

METAL BOND BLADES セラミック用 メタルブレード YM/AMシリーズ



■仕様と表示方法

1A8

形状

 MD
 400
 50
 AM030

 磁粒
 磁粒径
 集中度
 結合材

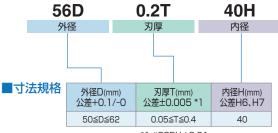
■砥粒

MD 標準砥粒 XD コーティング砥粒

■集中度

25, 50, 75, 100

■寸法と表示方法



*1 #325は±0.01

■粒度による製造可能タイプ

粒度	砥粒		
	MD	XD	
4000	•		
2500	•		
2000	•	•	
1300	•	•	
1200	•	•	
1000	•	•	
800	•	•	
700	•	•	
600	•	•	
500	•	•	
400	•	•	
325	•	•	

■粒度による製造可能刃厚

粒度	刃厚(mm)				
	0.05≦T <0.08 *2	0.08≦T <0.1	0.1≦T <0.15	0.15≦T <0.25	0.25≦T <0.4
4000	•	•	•	•	•
2500	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
1300	•	•	•	•	•
1200		•	•	•	•
1000		•	•	•	•
800			•	•	•
700			•	•	•
600			•	•	•
500			•	•	•
400					•
325					•

*2 外径56D以下で対応いたします。

■結合材

YM010	軟らかめ
YM030	標準
YM050	硬め

YMシリーズ セラミック全般

AM030	標準
AM050	硬め

AMシリーズ アルミナ向け

■ご注文に際して

ご注文にあたっては、当社カタログを参考に下記の項目について出来るだけ 詳しくお知らせ下さい。

- 1) 形状、寸法/具体的ブレード形状とご要求精度等
- 2) 仕様/ご希望の弊社仕様、現在ご使用中の製品の使用等
- 3) 切断ワーク・切断条件/使用機器、回転数、送り速度、クーラント流量等

■ご使用に際して

安全に使用していただくために、またブレードの性能を十分に引き出すために、ご使用 の前に製品に添付されている取り扱い説明書及び検査票の記載事項、加工機取り扱い 説明書を良くお読みの上ご使用下さい。

- ※本カタログは予告なく変更することがあります。
- ※本カタログは製品性能を保証するものではありません。

株式会社東京精密